

# Kemet DOMスラリーによるSiC CMP加工

- ハイレート
- 中間仕上工程向き

## 研磨平均レート 1 $\mu$ /h以上

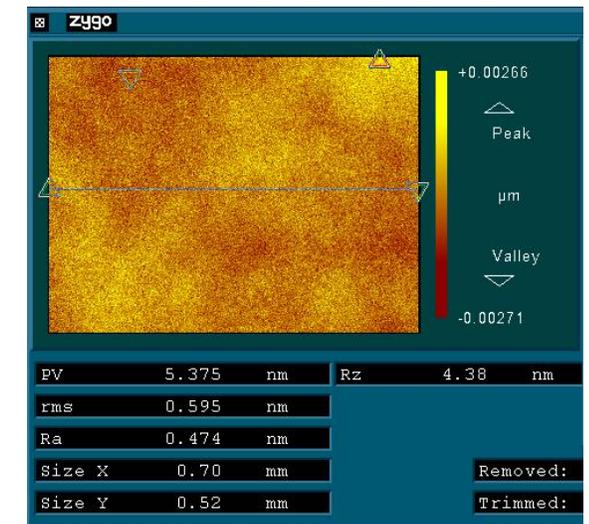
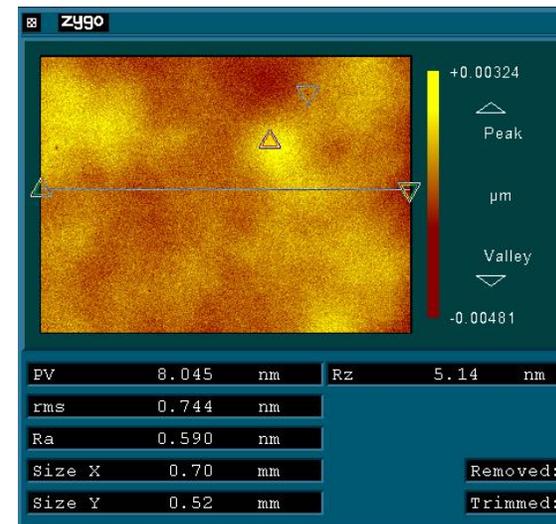
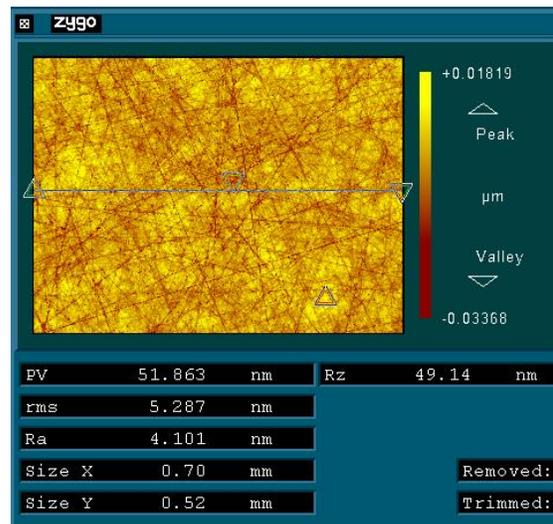
### ◇ 加工条件 ◇

加工面: 4in 4H-SiC Si面  
加工枚数: 1枚  
定盤径: 15インチ  
パッド: 不織布  
スラリー: kemetDOMスラリー  
流量: 10ml/min  
加圧: 300g/cm<sup>2</sup>  
回転数: 60rpm  
加工時間: 60分 × 2

加工前 Ra 4nm

60分 Ra 0.6nm以下

120分 Ra 0.5nm以下



ケメット・ジャパン株式会社

千葉県千葉市美浜区中瀬2-6 WBGマリブウェスト21階  
TEL: 043-213-9911 FAX: 043-213-9932  
INFO: info@kemet.jp URL: www.kemet.jp

